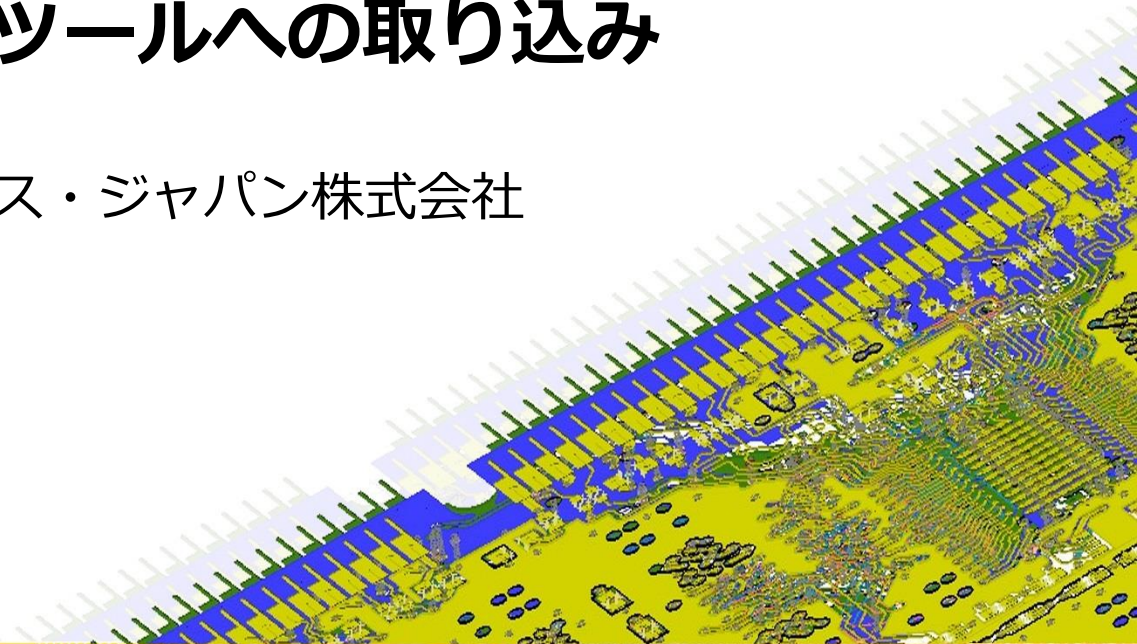




村田製作所様ご提供 C-フォーマットの ANSYS ツールへの取り込み

アンシス・ジャパン株式会社



Special Thanks to

- ・ 東芝デバイス&ストレージ株式会社 青木様
- ・ セイコーエプソン株式会社 眞篠様
- ・ 株式会社図研 古賀様

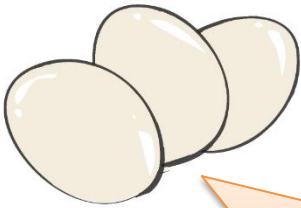
“卵”が先か“鶏”が先か？

EDA ベンダー

ユーザー（メーカー）様



LPB フォーマットに
対応して下さい！

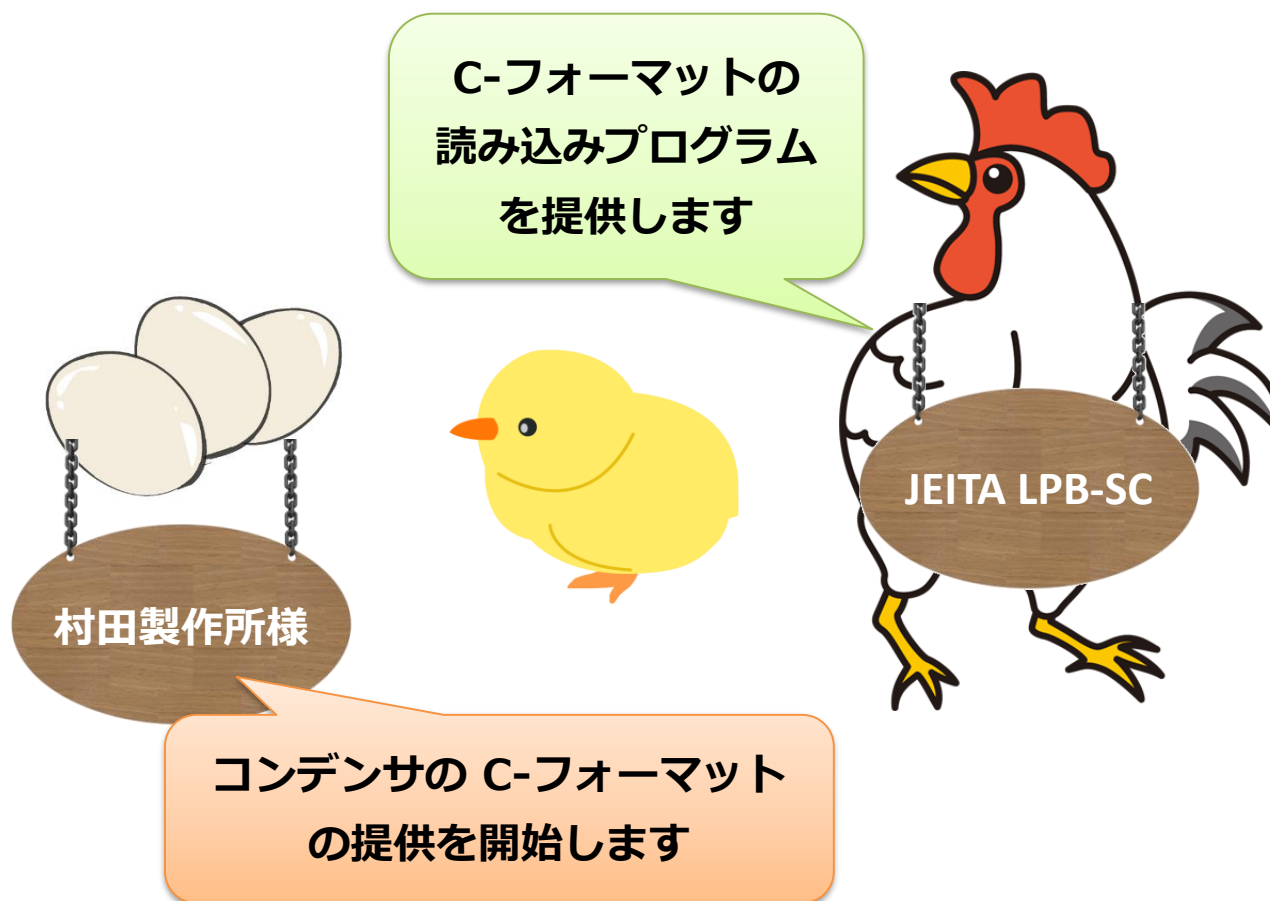


LPB フォーマットは使用
されていますか？
対応したら何か購入して
もらえますか？

“卵”が先か“鶏”が先か？・・・風向きが変わった？

部品ベンダー

ユーザー（メーカー）様

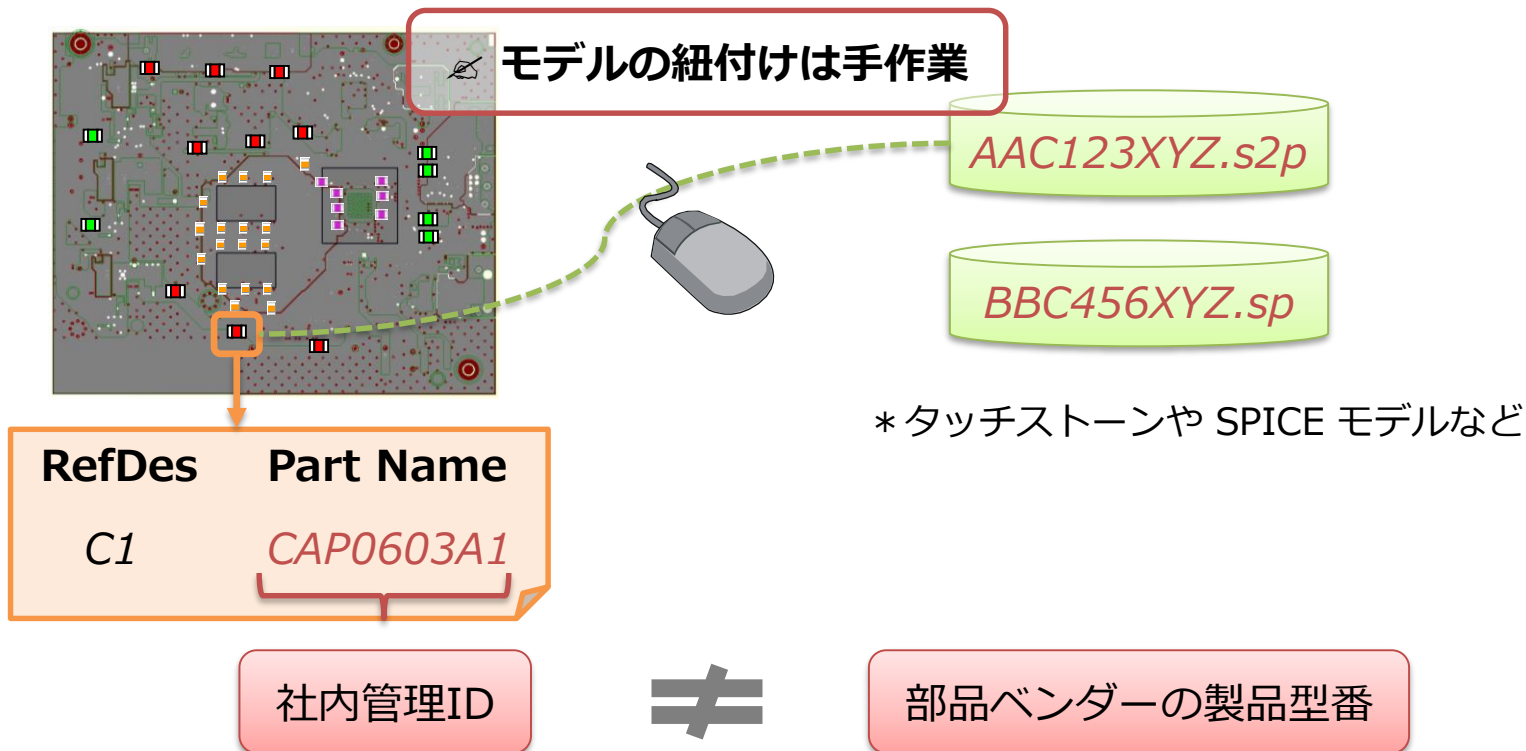


デザインキット（C-HUB）で出来るようになること

- ・ コンデンサのシミュレーション設定（C-フォーマット無し）
- ・ 各コンデンサに電気特性を表現したモデルを紐付けするのだが・・・

【レイアウトの部品情報】

【設定したい電気特性モデル】



デザインキット（C-HUB）で出来るようになること

- ・ コンデンサのシミュレーション設定（C-フォーマット無し）
 - ・ 部品ベンダー提供の電気特性モデルは？

【設定したい電気特性モデル】

- ✍ 部品ベンダー毎に提供の仕方は異なる
- ✍ EDA ベンダー毎にライブラリは異なる

AAC123XYZ.s2p

BBC456XYZ.sp

* タッチストーンや SPICE モデルなど



部品ベンダーの製品型番

デザインキット（C-HUB）で出来るようになること

・各フォーマットに含まれる情報

基板設計者（または CAD）提供

・ジオメトリ

G-Format（基板）

・部品情報
・RefDes
・社内管理ID

C-Format（基板）

・“社内管理ID”と
“製品型番”対照表

Excel File*

*Import Setup File

部品ベンダー提供

C-Format（部品）

・部品情報
・製品型番
・電気特性モデル

SPICEモデル

Touchstone

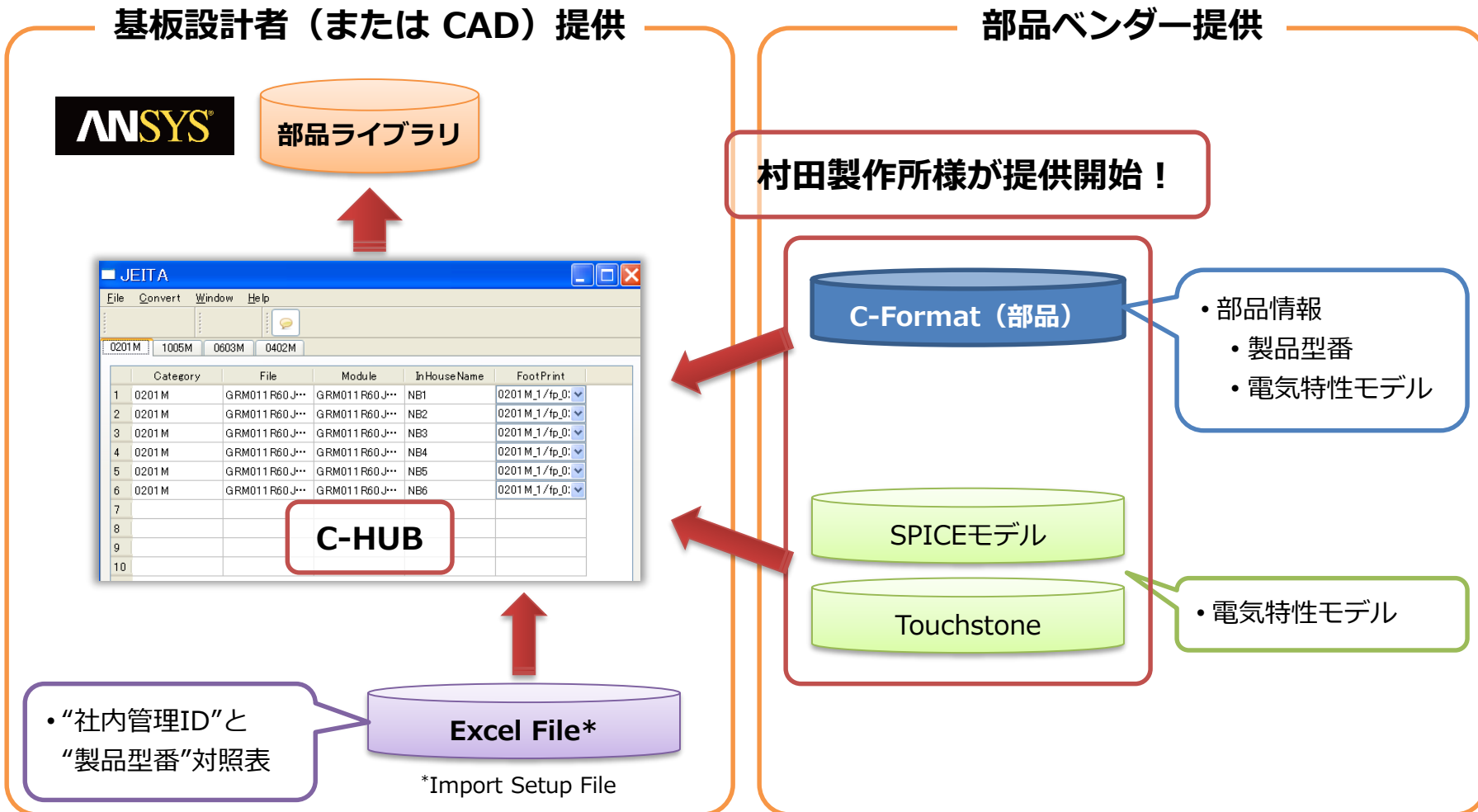
・電気特性モデル

デザインキット（C-HUB）で出来るようになること

・各フォーマットに含まれる情報

基板設計者（または CAD）提供

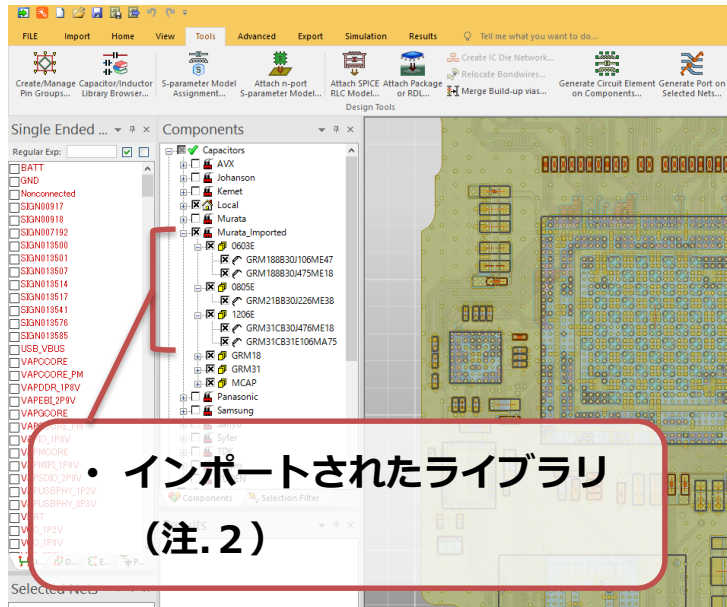
部品ベンダー提供



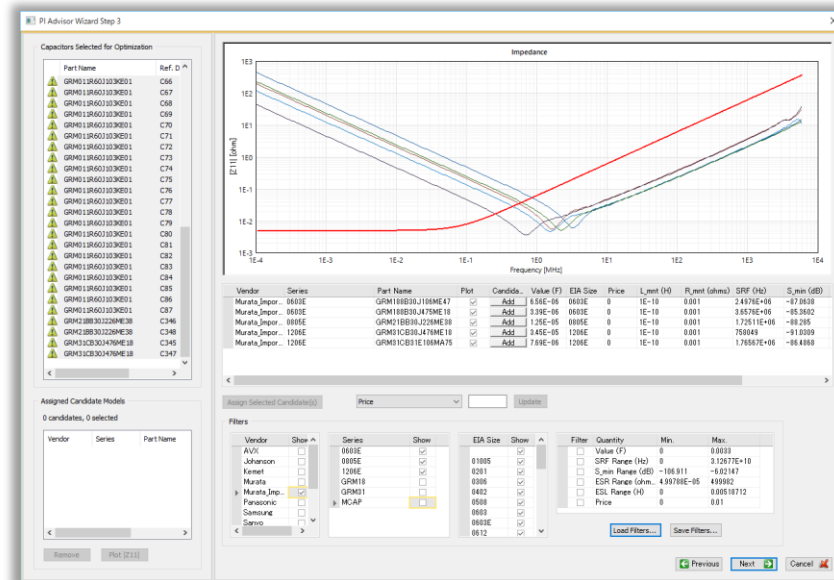
デザインキット (C-HUB) で出来るようになること

・ C-HUB でインポートされたライブラリの活用 (注. 1)

- ・ コンデンサの電気特性の自動割り当て (名前で自動紐づけ)
- ・ コンデンサの選択・配置の最適化 (PI Advisor)



ANSYS SIwave



PI Advisor (ANSYS SIwave)

注. 1 弊社製品は C-フォーマットへ未対応な為、.cmpファイルなどで基板の部品情報をインポートする必要があります。

注. 2 本テスト時には社内管理 ID は設定せず、村田製作所さんの製品型番をそのまま採用しています。

お願い

ANSYS

ユーザー（メーカー）様



アンケートにご協力下さい。

- 現在の LPB フォーマットの採用状況
- 今後の LPB フォーマットを採用の意思
- LPB フォーマット対応のご要望